

股票代號:3444

2023 Investor Meeting

法人說明會

執行長 張宏基

2023.12.05

善言 人:盧修滿協理 / claire@niching.com.tw

代理發言人:邱智芳協理 / chris@niching.com.tw

股務聯絡人:陳玲芝課長 / cherry@niching.com.tw



投資安全聲明

本內容可能包含「前瞻性陳述」,包括(但不限於)未來展望、預測及估算等預期性之陳述。這些前瞻性陳述乃基於本公司經營的信念及對於未來的目前看法。這些看法可能受到內外在風險及不確定性因素影響,有造成實際結果與陳述內容顯著不符之可能。

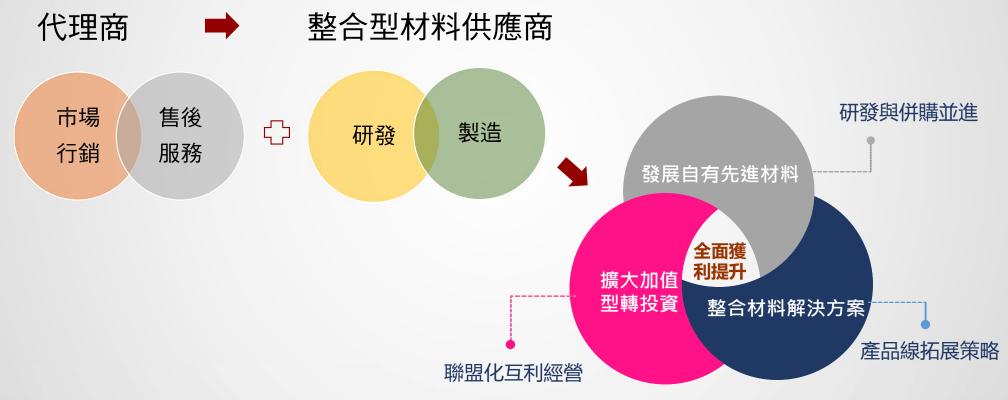
本文件所做出的任何前瞻性陳述僅於陳述日當日適用,投資者應有自主 判斷,不應過分依賴該等前瞻性陳述。對於這些看法,除法規規定外,未來若有任何變更或調整時,本公司並不負責隨時提醒或更新。本節所述的警告聲明適用於本簡報所載的所有前瞻性陳述。





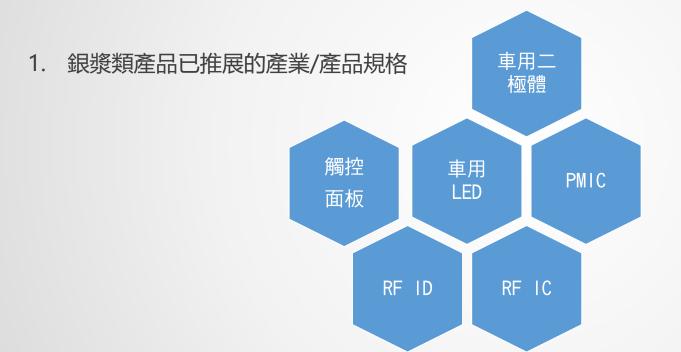


營運三佈局:轉型全面提升獲利





自有研發



產品優勢	特色
大尺寸晶片固晶	• 15 x 15 mm • 低模數
超低溫燒結	175oC燒結銀低應力具高信賴性
超高熱導性	>230 W/mk高功率半導體及LED元件應用於SiC, GaN
高接著強度及 信賴性	•可對應多種接著表面 •通過TCT1000及MSL1



自有研發

銀漿產品發展藍圖 現況 2024E 2025E **IGBT** RF-IC 超高導熱TIM 低溫燒結銀 SiC MOSFET 消費性IC 高功率元件及LED LED車前燈 車用二極體 高導熱銀漿 LED車後燈 絕緣半導體封裝膠 高導熱TIM 觸控面板 智慧醫療電子部件 車室內電子部件 客製化銀漿 超低溫冷鏈溫度監控 IOT電子部件 次世代顯示器 系統



自有研發

3. 通過小功率元件客戶認證



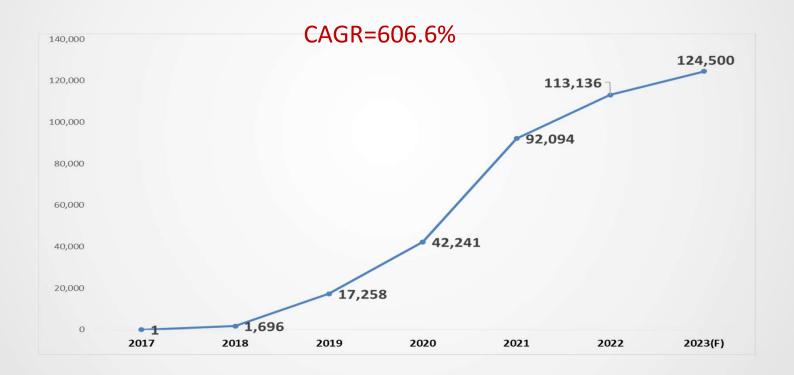


併購Heat Sink均熱片廠商

- 1. 建置Heat Sink電鍍不同製程,包括電解電鍍鎳&化學電鍍鎳,可承接所有 封裝客戶需求,不受電鍍製程差異限制。
- 2. 成為客戶Heat Sink 之安全、及時供貨、高品質高技術的主要供應商之一
- 3. 2024啟動併購均熱片廠商:逐步增加股權方式完成收購



均熱片歷年營收





布局二>擴大加值型轉投資

聯盟化經營 互利互惠

- 1. Simmtech 蘇州(STNS)由成本模式轉為利潤模式,並交由利機主導,佣金率提高並擴大利機持股,2024有大幅成長投資收益的機會。
- 2. 利機與日本Enplas集團藉由擴大利騰台灣持股,共同經營大陸Socket市場
- 3. 利機與勤輝科技共投資精材科技,擴大Emboss、Reel等驅動IC材料市場



布局二>擴大加值型轉投資

聯盟化互利經營的加深策略

1. 現有三大加值型轉投資長期穩定貢獻獲利





布局三>整合材料解決方案

產品線拓展策略









歷年營收/接單金額





歷年毛利率

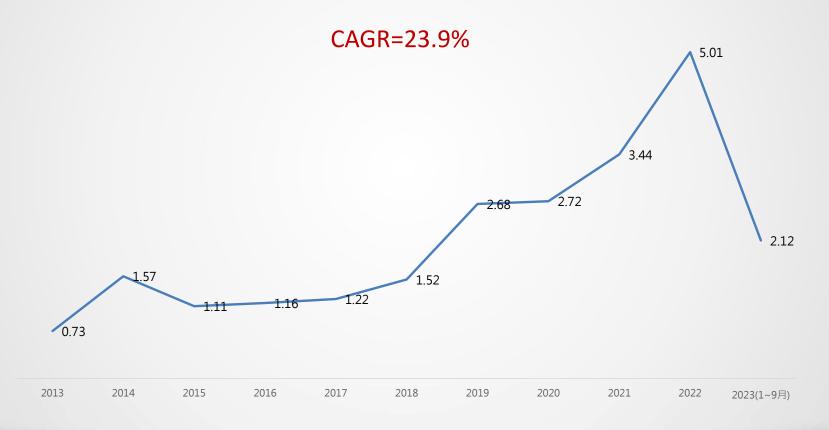






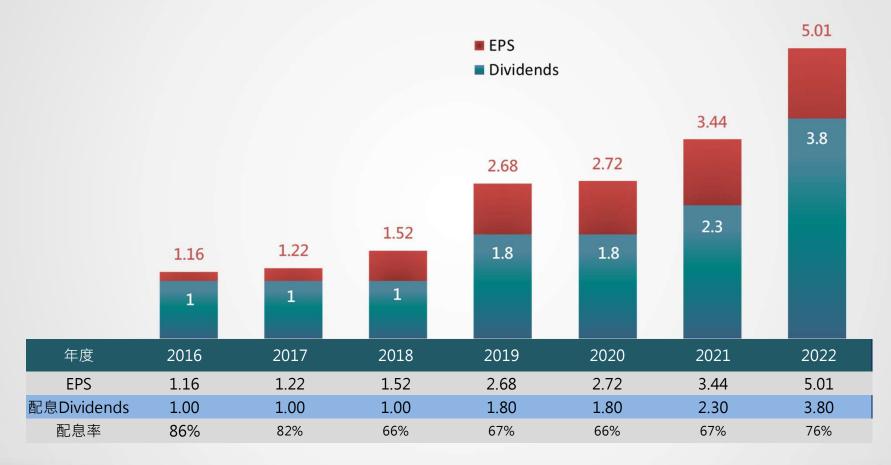
歷年每股稅後盈餘

單位:元





歷年配息率





總結

- 一. 銀漿產品正式取得小功率元件客戶認證通過,為銀漿產品建立新里程 碑,肯定自有技術發展有成
- 二. Heat Sink建置電解鎳電鍍生產線完成,預計明年下半年可開始供貨, 對於新增客戶&營收成長有顯著幫助
- 三. 深化與Simmtech合作,共同開拓System IC Substrate市場,對於中長期接單金額、獲利將有數倍成長
- 四. 加值型轉投資獲STNC營運主導權,獲利貢獻有望大幅成長
- 五. 切割刀及研磨刀輪初步獲得客戶優異評價,未來將成為營運成長動能 另一大亮點。



THANKS